



■ 产品用途

用于微处理器、功率半导体器件、固态继电器的散热

■ 产品特点

- 低的接触热阻
- 优异的电气绝缘性能
- 不需要机械紧固件
- 符合环保要求要求
- ISO认证, IATF1认证, IECQ认证

■ 产品规格

| 产品型号 | 厚度 mm | 基材 | 硬度 Shore A | 导热系数 W/m·K | 体积电阻 Ω·cm | 击穿电压 AC, KV | 热阻°C·in ² /W@50Psi | 剪切强度 MPa | 储存温度 °C |
|--------|-----------|----|---------------|---------------|----------------------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|
| 测试标准 | ASTM D374 | / | ASTM D2240 | ASTM D5470 | ASTM D257 | ASTM D149 | ASTM D5470 | ASTM D1002 | / |
| BNTK15 | 0.19 | PI | 80 | 1.4 | 1.0×10 ¹⁵ | 6.0 | 0.41 | 3 | 0~10°C |